

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2022年2月24日(24.02.2022)



(10) 国際公開番号

WO 2022/038700 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/60 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2020/031226

(22) 国際出願日: 2020年8月19日(19.08.2020)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(71) 出願人: 株式会社新川(SHINKAWA LTD.) [JP/JP]; 〒2088585 東京都武蔵村山市伊奈平 2 丁目 5 1 番地の 1 Tokyo (JP).

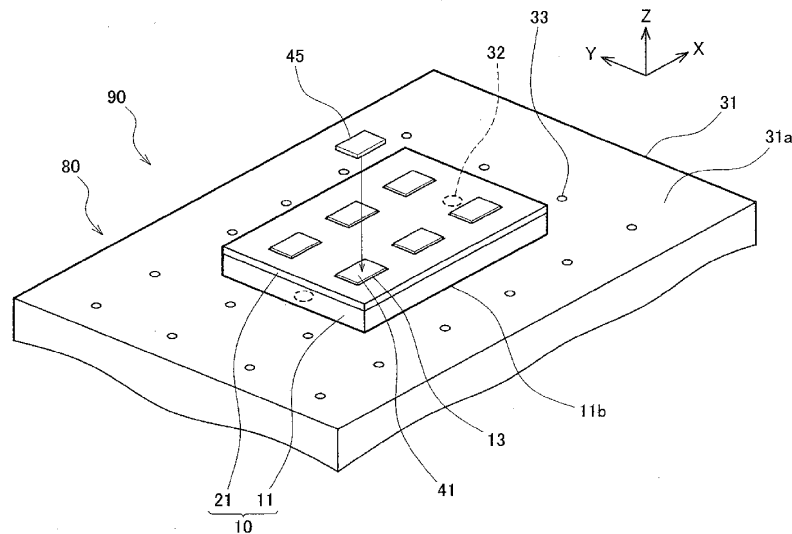
(72) 発明者: 瀬山 耕平(SEYAMA, Kohei); 〒2088585 東京都武蔵村山市伊奈平 2 丁目 5 1 番地の 1 株式会社新川内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 特許業務法人 Y K I 国際特許事務所 (YKI INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS); 〒1800004 東京都武蔵野市吉祥寺本町一丁目 3 4 番 1 2 号 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,

(54) Title: SUBSTRATE HOLDER, BONDING SYSTEM, AND BONDING METHOD

(54) 発明の名称: 基板保持具、並びに、ボンディングシステム及びボンディング方法



(57) Abstract: A bonding system (90) is provided with a bonding device (80) for bonding semiconductor chips (45) to individual substrates (41), and a substrate holder (10) for holding the individual substrates (41), the bonding device (80) being provided with a stage (31) for fixing, by suction, the substrate holder (10) on a placement surface (13a), the substrate holder (10) being provided with a plate-shaped base (11) and a positioning member (21) that is provided on the base (11) and that defines the position of the individual substrates (41), the base (11) having an upper surface (11a) on which the

WO 2022/038700 A1

[続葉有]

ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))

individual substrates (41) are placed and a lower surface (11b) that is fixed by suction onto the placement surface (31a).

(57) 要約: 半導体チップ(45)を個片基板(41)にボンディングするボンディング装置(80)と、個片基板(41)を保持する基板保持具(10)と、を備えるボンディングシステム(90)であって、ボンディング装置(80)は、載置面(13a)の上に基板保持具(10)を吸着固定するステージ(31)を備え、基板保持具(10)は、上面(11a)に個片基板(41)が載置され、下面(11b)が載置面(31a)に吸着固定される板状のベース(11)と、ベース(11)の上に設けられて個片基板(41)の位置を規定する位置決め部材(21)と、を備える。